
2005年5月2日

2005年3月期 決算説明会

東京エレクトロン デバイス株式会社



TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED

2005年3月期 業績

(単位:百万円)

	2004年3月期		2005年3月期		増減率 (%)
		百分比%		百分比%	
売上高	85,738	100.0	88,079	100.0	2.7
売上総利益	11,377	13.3	11,666	13.2	2.5
営業利益	3,182	3.7	3,106	3.5	2.4
経常利益	2,952	3.4	2,820	3.2	4.5
当期純利益	1,680	2.0	1,916	2.2	14.1
1株当たり当期純利益	35,991.94円		20,597.25円		
R O E	13.8%		14.2%		
1株当たり年間配当金	13,300円		5,500円		
従業員数	534人		562人		

* 発行済株式数

2004年3月期: 46,000株

2005年3月期: 92,000株

2005年3月期 資産

(単位:百万円)

科目	2004年3月期	2005年3月期	増減額
現預金	638	879	240
受取手形・売掛金	20,441	21,217	776
たな卸資産	12,555	10,649	1,905
その他流動資産	867	764	103
有形固定資産	346	765	418
無形固定資産	368	243	125
投資その他の資産	2,206	1,468	737
資産計	37,424	35,988	1,435

2005年3月期 負債・資本

(単位:百万円)

科目	2004年3月期	2005年3月期	増減額
買掛金	7,612	8,585	973
短期借入金	3,000	5,000	2,000
その他流動負債	2,956	2,238	718
長期借入金	8,000	3,000	5,000
その他固定負債	3,080	2,948	131
負債計	24,649	21,772	2,876
資本金	2,495	2,495	
資本剰余金	2,054	2,054	
利益剰余金	8,224	9,665	1,441
資本計	12,775	14,216	1,441
負債・資本計	37,424	35,988	1,435

2005年3月期 キャッシュ・フロー

(単位:百万円)

	2004年3月期	2005年3月期	増減額
営業キャッシュ・フロー	2,399	4,291	1,891
投資キャッシュ・フロー	243	593	350
財務キャッシュ・フロー	1,998	3,457	1,458
現金等の増減額	155	240	85

2005年3月期 品目別売上高

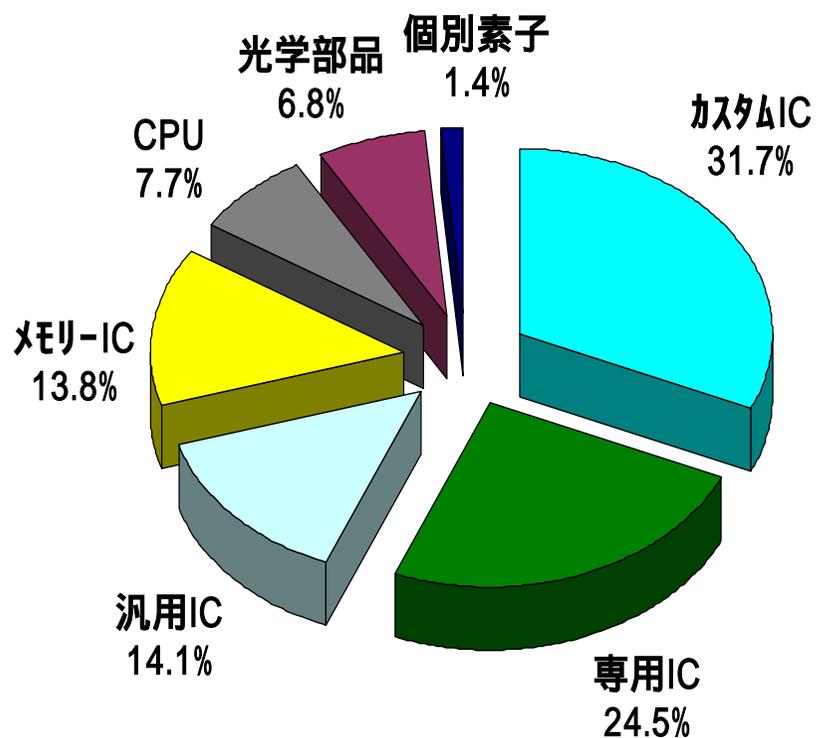
(単位:百万円)

品 目*	2004年3月期		2005年3月期		増減率 (%)
	売上高	構成比%	売上高	構成比%	
半導体製品	75,468	88.0	77,655	88.2	2.9
ボード製品	4,325	5.1	4,801	5.4	11.0
ソフトウェア	2,998	3.5	2,726	3.1	9.1
一般電子部品	2,944	3.4	2,897	3.3	1.6
合 計	85,738	100.0	88,079	100.0	2.7

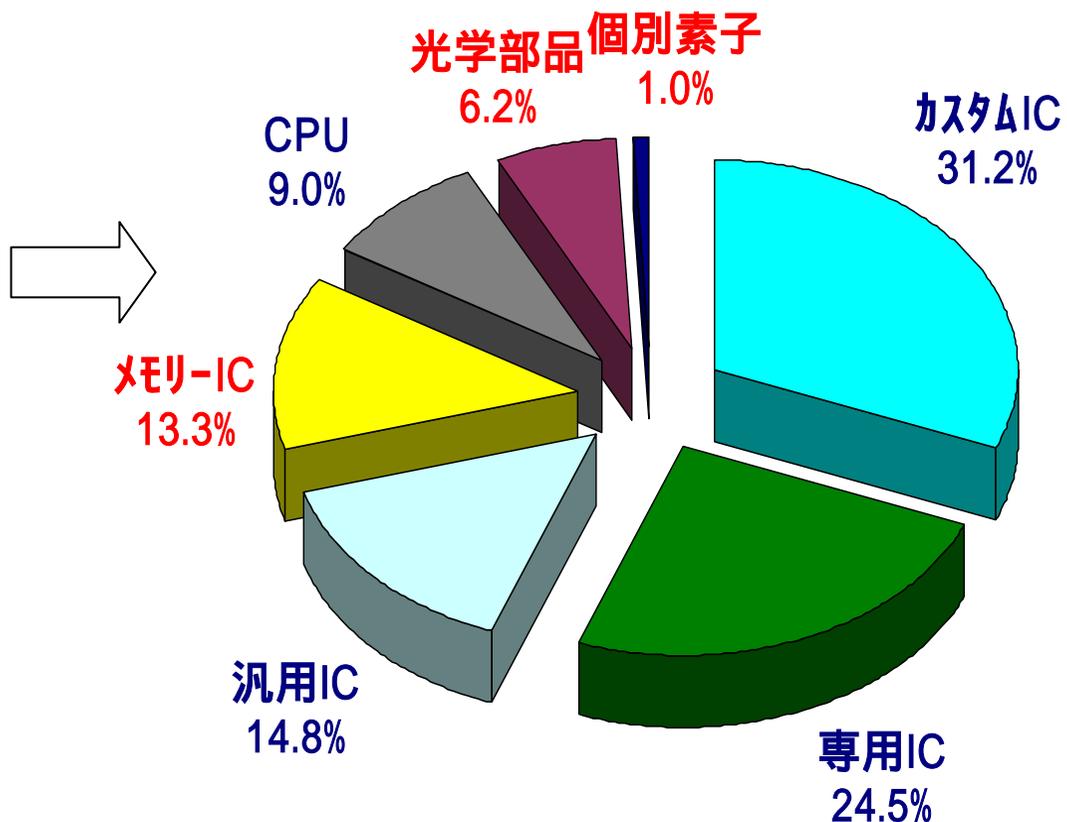
* 各品目についての説明は、P.32～P.34をご参照ください。

2005年3月期 半導体製品売上構成比

< 2004年3月期 >



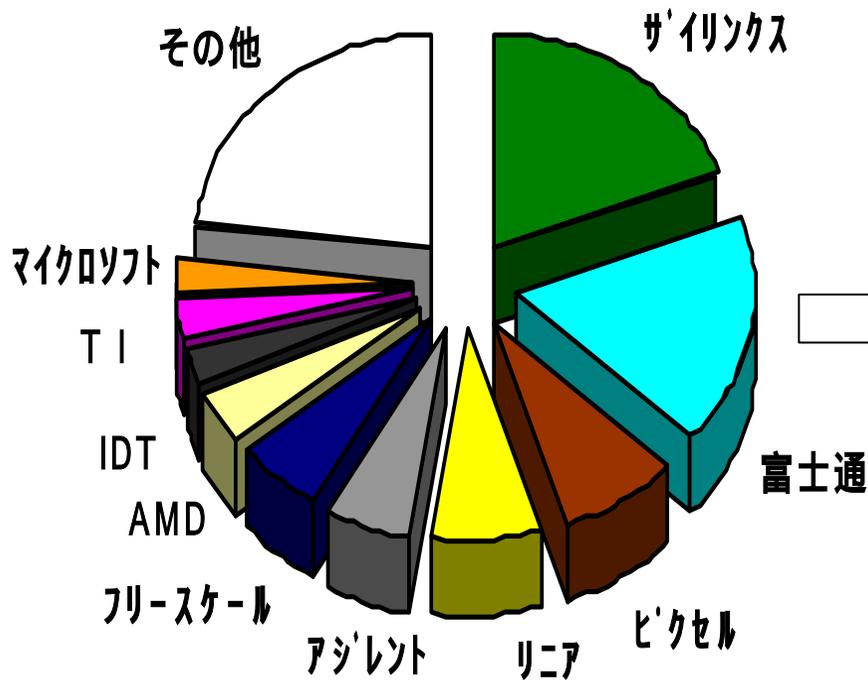
< 2005年3月期 >



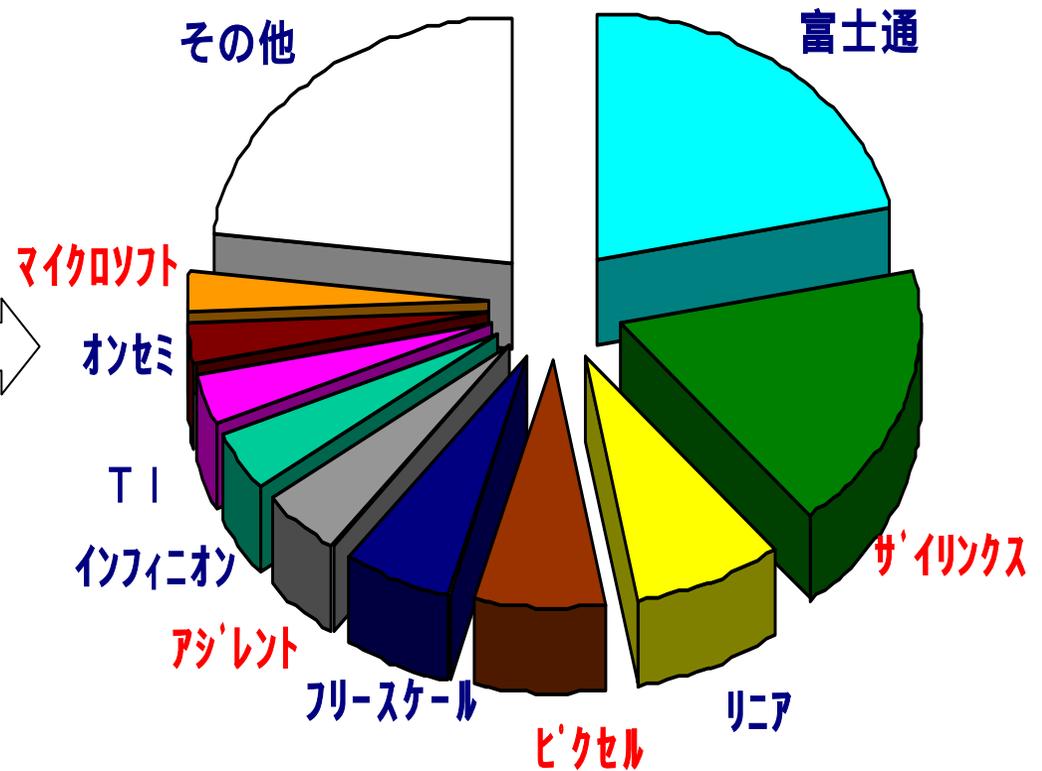
* 品目についての説明は、P.32 P.33をご参照ください。

2005年3月期 商品別売上構成比

< 2004年3月期 >



< 2005年3月期 >



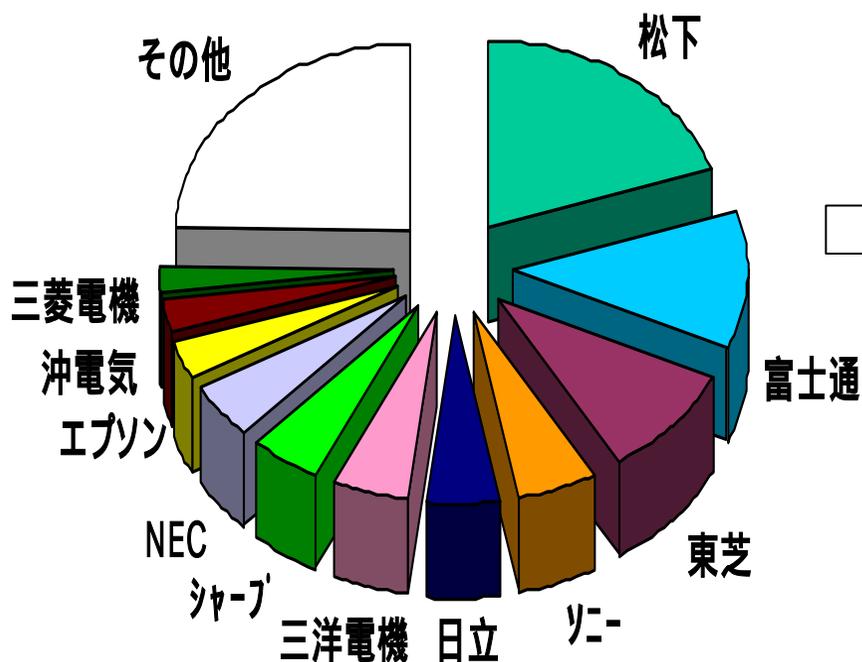
注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

2005年3月期 主要商品別売上増減要因

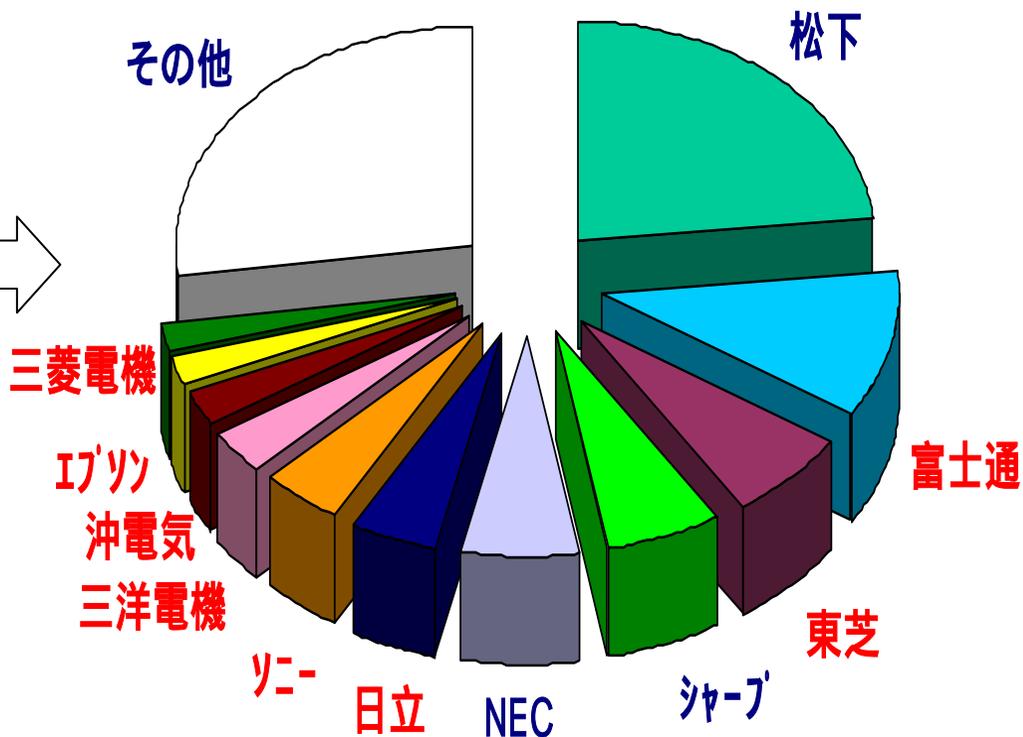
仕入先名	増減率	要 因
富士通(株)	27%	薄型TV、民生機器向け伸長
ザイリンクス社	7%	商権移動を除くと前年比横ばい
リニアテクノロジー社	8%	販売拡大継続
ピクセルワークス社	10%	プロジェクト向け単価下落・在庫調整
フリースケール・セミコンダクタ社	8%	産業機器向け堅調
アジレント・テクノロジー社	24%	商権移動、携帯電話端末向け不調
インフィニオン社	145%	携帯電話端末向け好調
TI社	19%	商権拡大
開発ビジネス	36%	設計受託案件増加

2005年3月期 顧客別売上構成比

< 2004年3月期 >



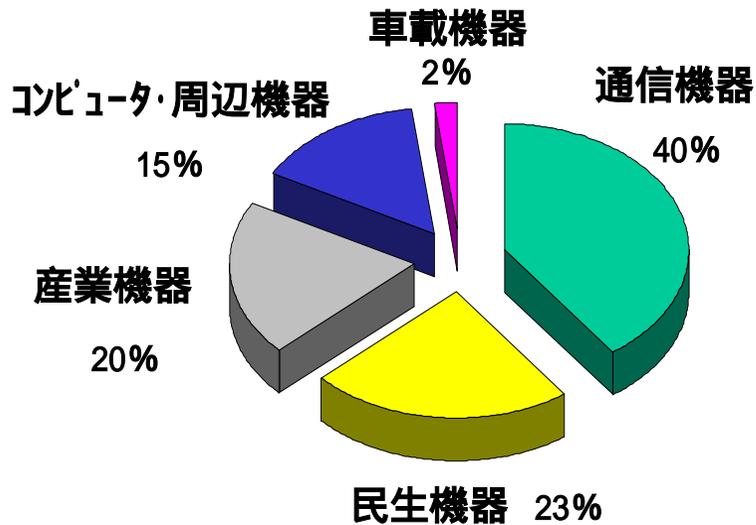
< 2005年3月期 >



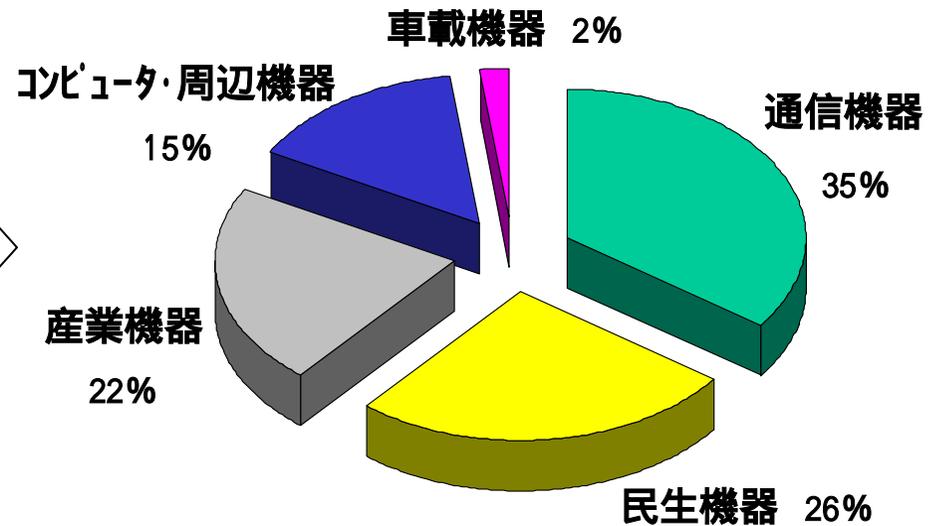
注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

2005年3月期 用途別売上構成比

< 2004年3月期 >

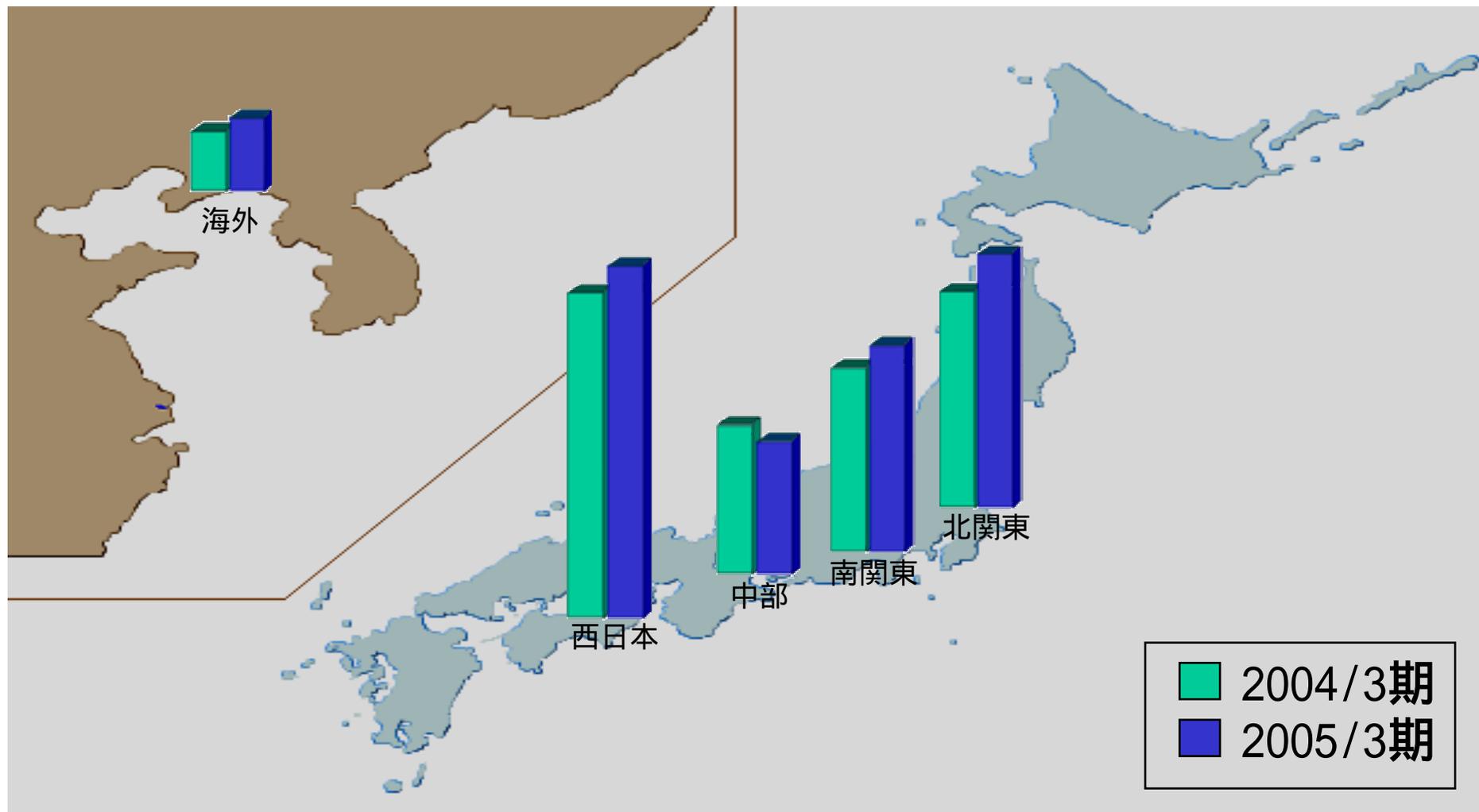


< 2005年3月期 >



用途	主なアプリケーション
通信機器	ターミナルアダプタ、ケーブルモデム、携帯電話、ルーター、交換機、基地局
民生機器	デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、チューナー、液晶TV、プラズマTV、DVD
産業機器	セキュリティ監視機器、医療機器、放送機器、テスター、半導体製造装置
コンピュータ・周辺機器	プリンター、プロジェクタ、POS、PC、ワークステーション、汎用コンピュータ
車載機器	カーナビゲーション、カーオーディオ

営業拠点別 売上構成



2005年3月期 トピックス

セールスオフィス3箇所開設

京都(4月) 浜松(9月) 三島(10月)

開発ビジネスをブランド化(6月)

ISO 14001取得(7月)

◆ 株式分割実施(9月)

株式分割比率 1:2 (1株 2株)

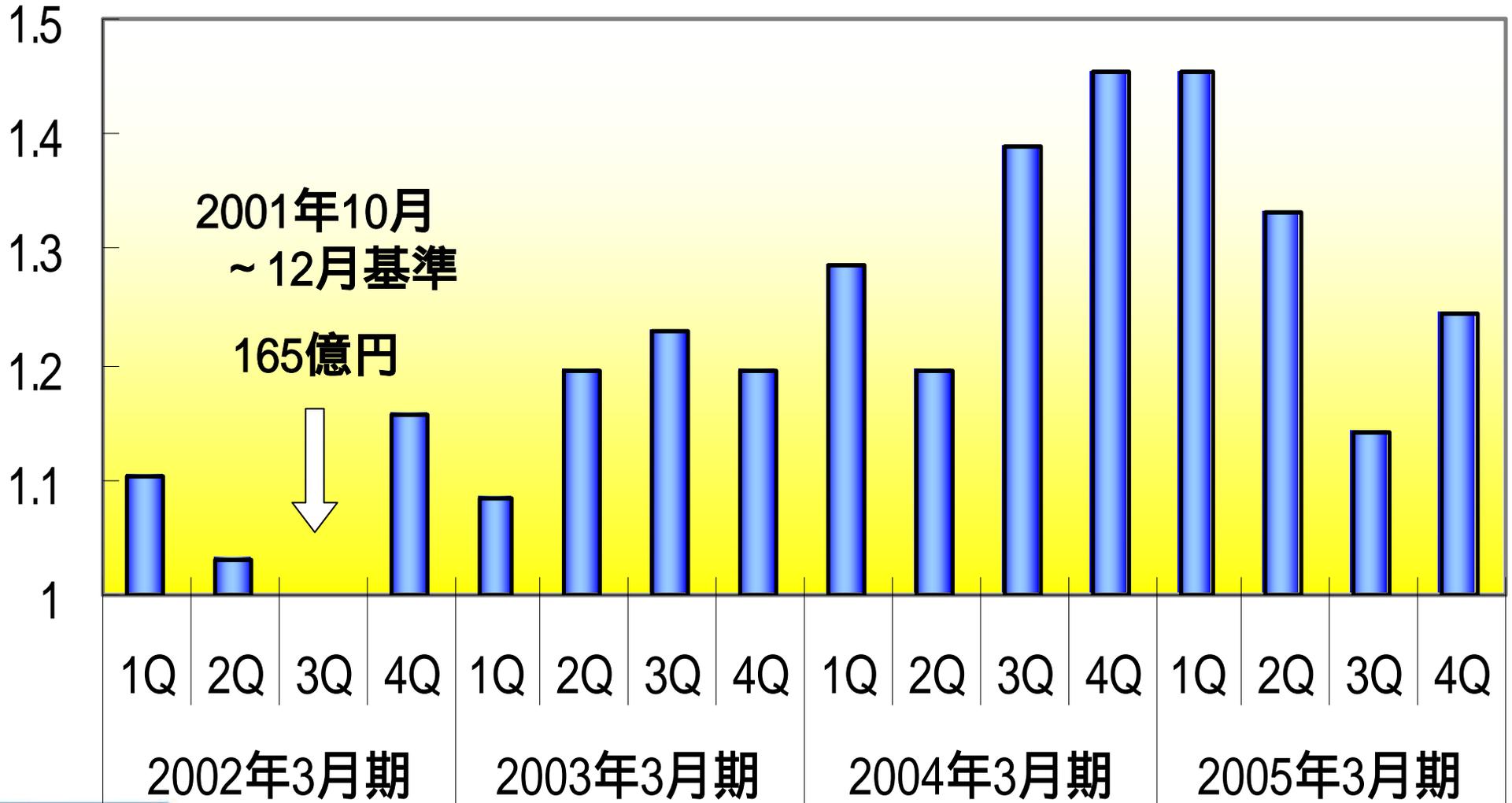
東京エレクトロン デバイス香港 設立(1月)

今期の業績予想について



受注变化推移

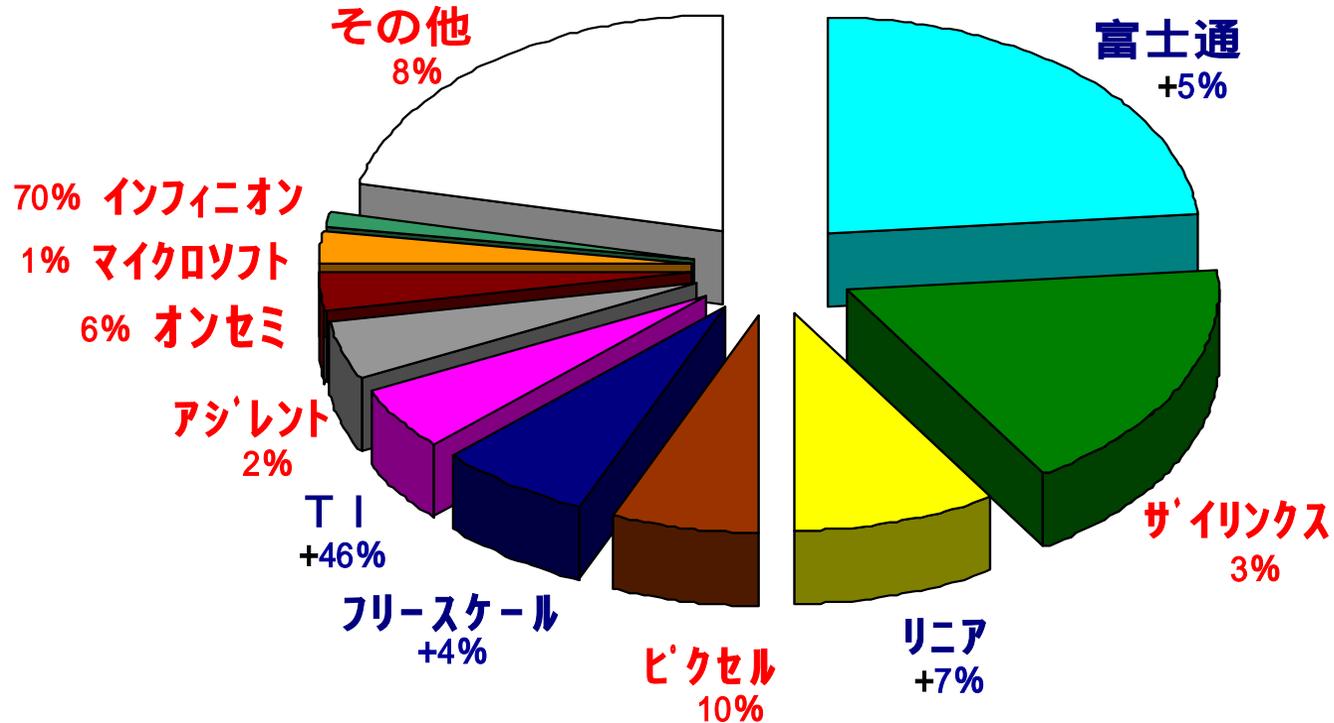
(倍)



用途別 売上構成見込み

用途	主なアプリケーション	傾向 前年比
通信機器	基幹系通信インフラ	→
	携帯電話端末	↘
民生機器	液晶TV・プラズマTV	↗
	DVD	→
産業機器	テスター	↗
	FA機器、医療機器	→
コンピュータ及び 周辺機器	PC・周辺機器	→
	プロジェクト	→
車載機器	カーナビゲーション	↗

主要商品別 売上構成見込み



注) 上記見込みは、各仕入先の業績には連動いたしません。
数字は、前年比増減見込みを記載しております。
社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

2006年3月期 連結業績予想

(単位:百万円)

	上期予想	下期予想	通期予想	対前年 増減率(%)
売上高	40,000	45,000	85,000	3.5
経常利益	1,110	1,760	2,870	1.8
当期純利益	640	1,030	1,670	12.7
1株当たり配当金	3,000円	3,000円	6,000円	

1株当たり予想当期純利益(通期): 18,152.17円

予想 R O E : 11.3 %

* 連結子会社:東京エレクトロン デバイス香港



中期の課題

マーケティング

顧客要求の商品/ビジネスモデルへの対応

収益の確保

安定した利益成長の実現

収益率の向上

開発ビジネスの成長

今期の活動方針

東京エレクトロン デバイス香港の立上げ

- 今期売上計画42億円

新規顧客の開拓

- 高付加価値商品の販売促進

開発ビジネス

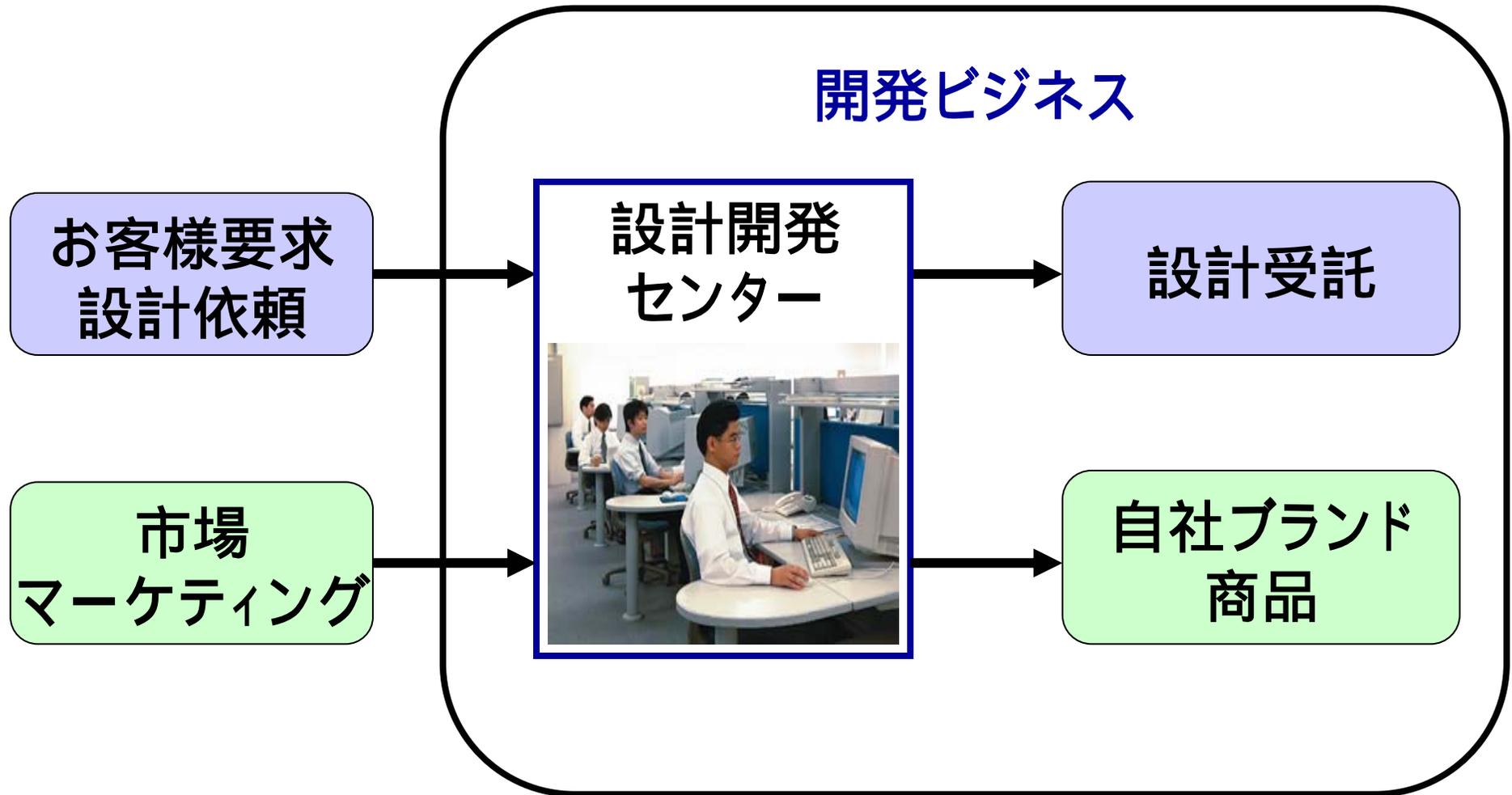
- 設計受託業務の受注拡大
- 自社ブランド商品のマーケティングの推進

開発ビジネスについて

inrevium

(インレビウム)

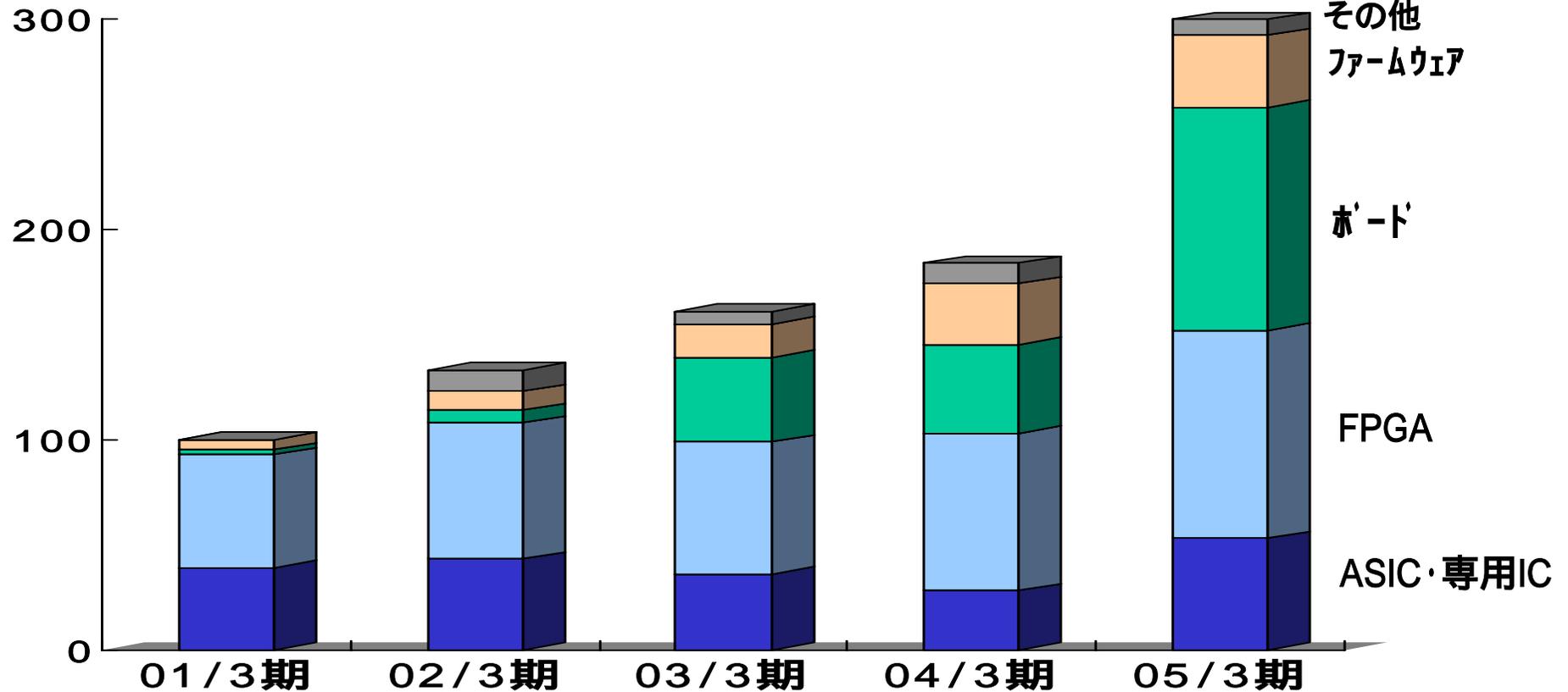
高付加価値事業への取組み



設計開発センター 開発件数

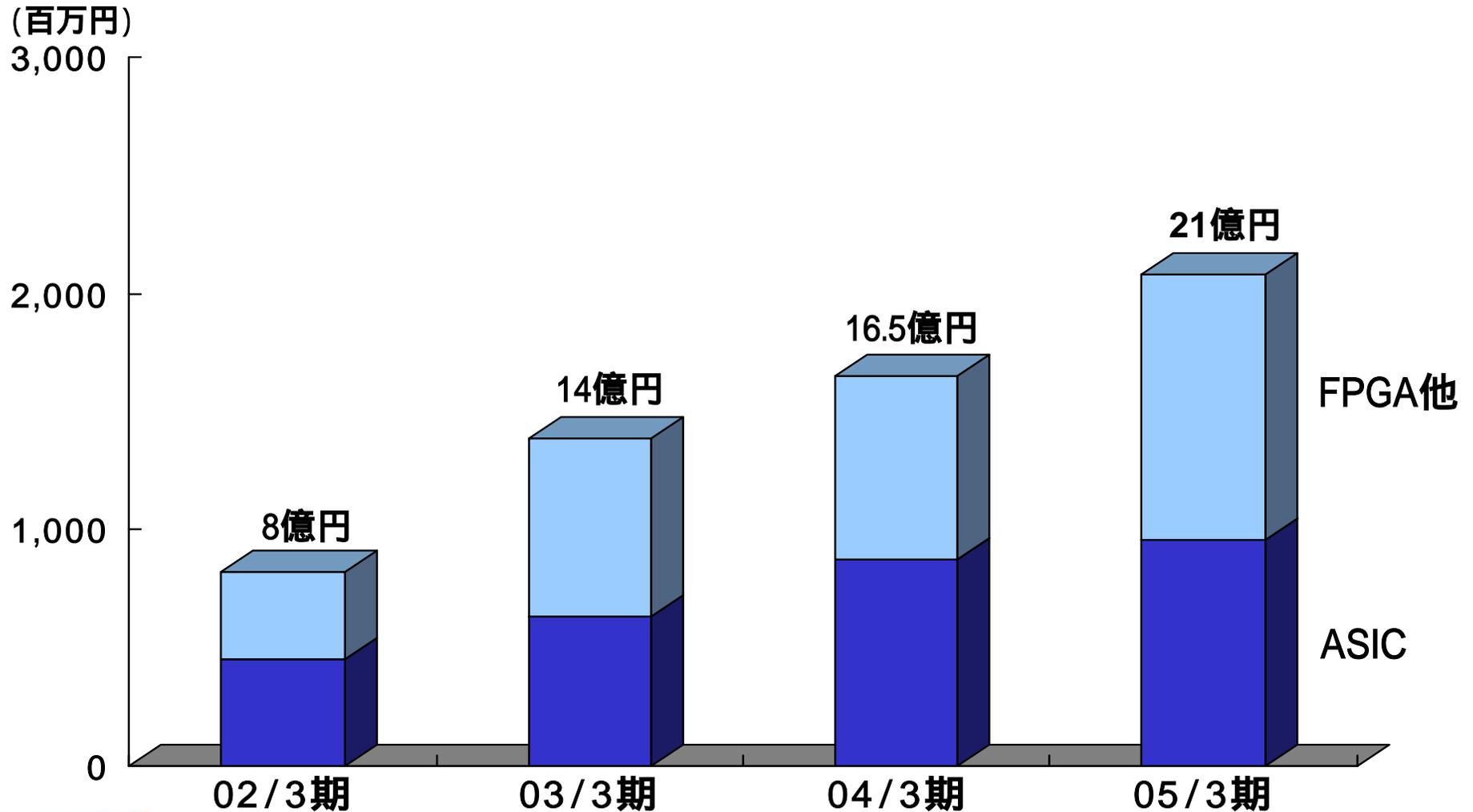
2005年3月期 開発件数: 304件

(単位:件)

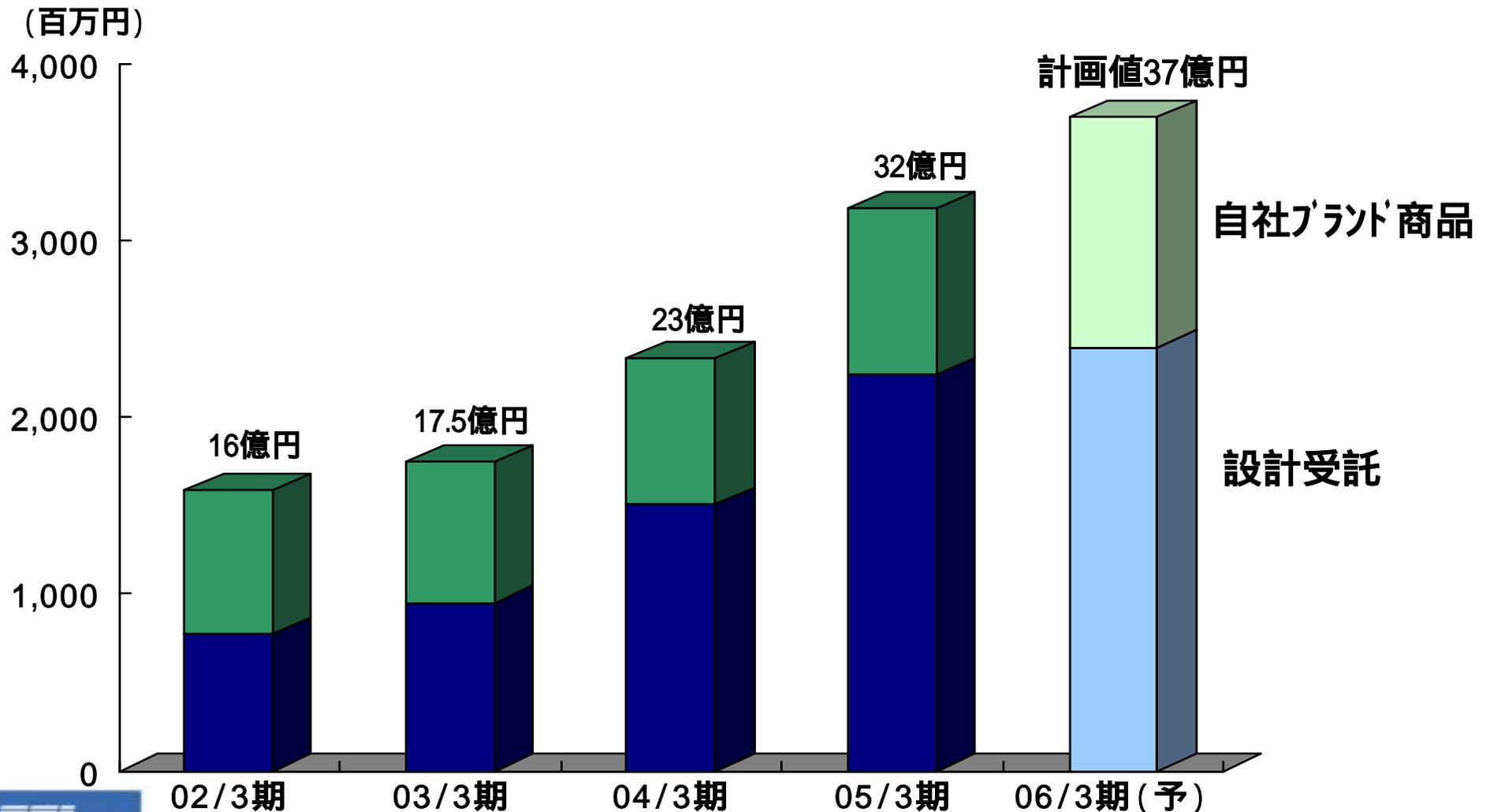


* フォームウェア:機器の中に組み込まれるソフトウェア

設計受託業務 受注額推移



開発ビジネス 売上高推移・計画

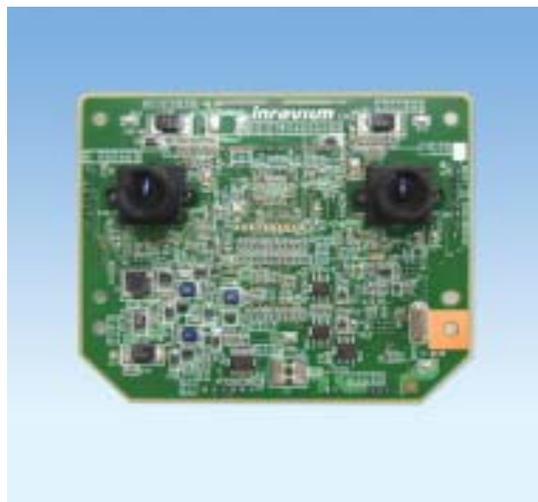


市場ニーズ・お客様要求 (開発件数7件)

< 売上高 >

2005年3月期	2006年3月期 計画
400百万円	700百万円

ステレオカメラボード



2つのCCD画像を同時に
取込み立体画像を認識

TD-BD-SCAM



(写真提供: NEC)

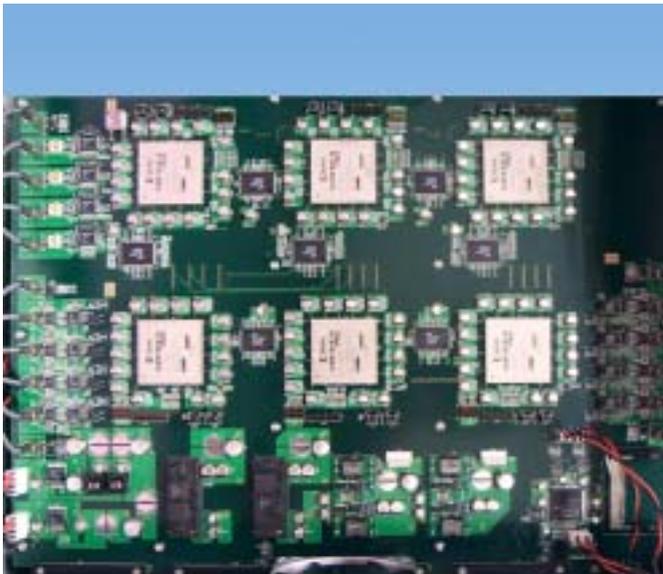
- ・用途 : ロボット(愛・地球博「NECのチャイルドケアロボットPaPeRo」に採用)
自動車 障害物認識センサー

産学連携 (開発件数4件)

< 売上高 >

2005年3月期	2006年3月期 計画
90百万円	190百万円

信号処理用ボード



高速通信回路の評価を短期間で実施

TD-BD-SPP1000

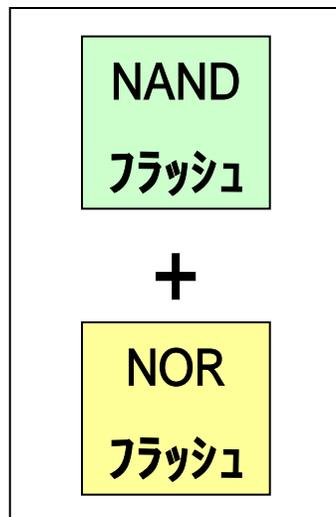
東京工業大学との共同開発

保有技術活用（開発件数4件）

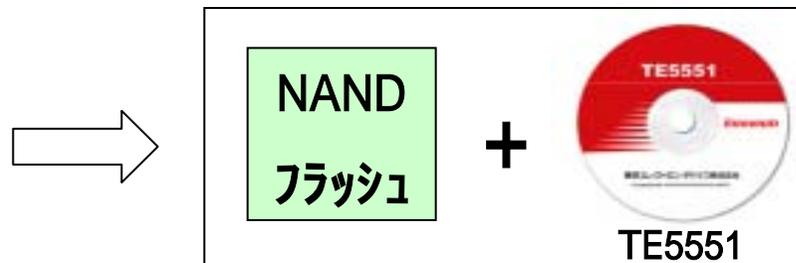
< 売上高 >

2005年3月期	2006年3月期 計画
300百万円	250百万円

ブート機能付NANDフラッシュ メモリ制御用IP



NANDフラッシュメモリでNORフラッシュメモリの機能を発揮



- ・メリット: 安価、基板スペースの節約、実行速度の向上
- ・用途 : デジタルカメラ、携帯電話

取扱い商品との組合せ (開発件数2件)

< 売上高 >

2005年3月期	2006年3月期 計画
150 百万円	160 百万円

プロジェクター用周辺制御IC

ピクセルワークス社ICと組合せて小型・省電力化



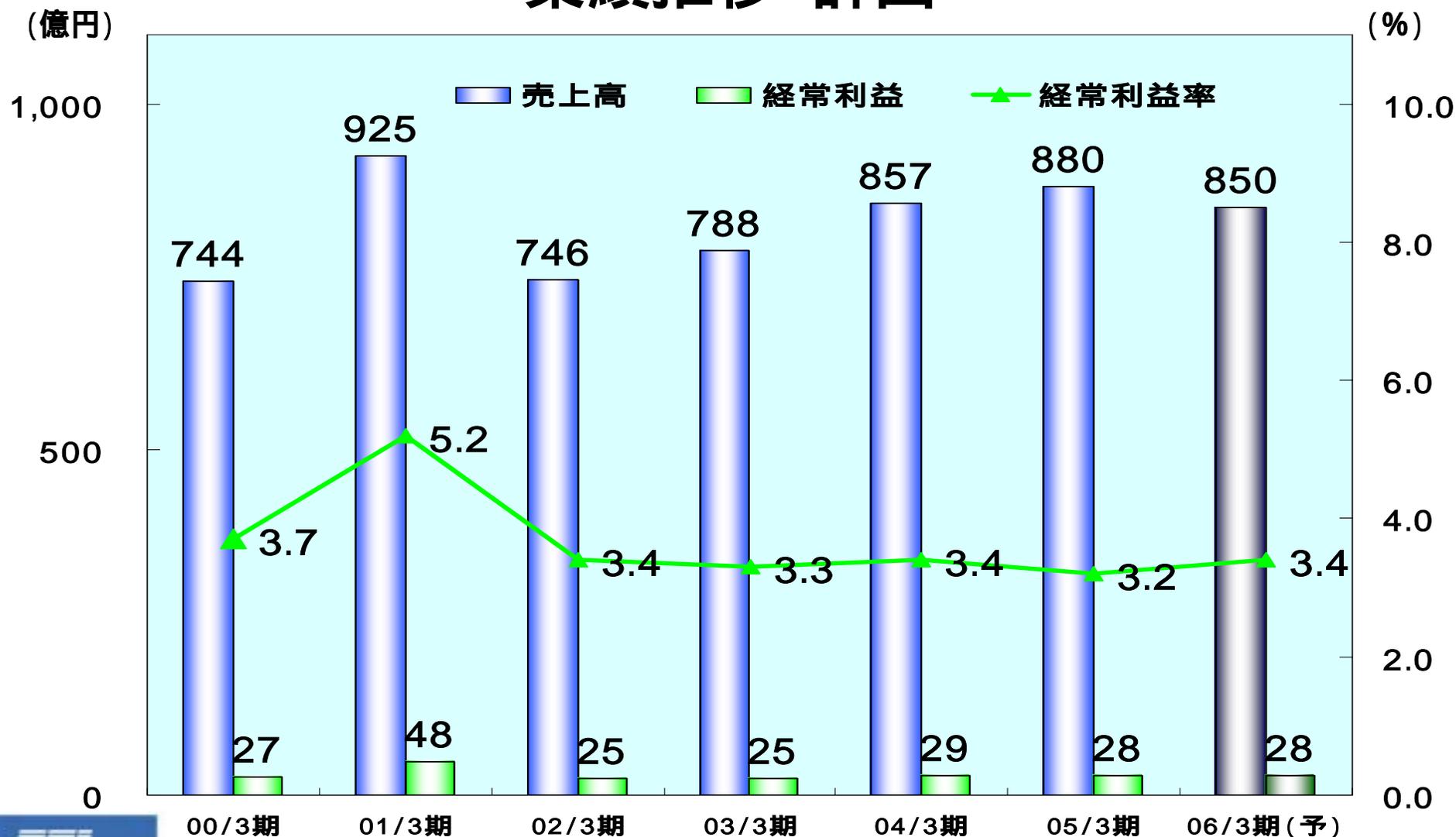
資料取扱い上の注意

このプレゼンテーションで述べられている将来の当社事業に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。

当社の参画するエレクトロニクス業界は変化のスピードが大変速く、また、世界経済、半導体市況など、当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。

したがって、今後当社の業績見通しが本プレゼンテーションと異なる可能性があることをお含みおきください。また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。

業績推移・計画



品目別仕入先名

	品目	主な仕入先名
半導体製品	カスタムIC	富士通(株)、サイリンクス社
	専用IC	インフィオン社、富士フイルムマイクロデバイス(株)、フリースケール・セミコンダクタ社、ピクセルワークス社、サーリンク・セミコンダクター社、インレビウム
	汎用IC	リニアテクノロジー社、オン・セミコンダクタ社、TI社
	メモリIC	AMD社、富士通(株)、IDT社
	CPU	AMD社、フリースケール・セミコンダクタ社、富士通(株)、TI社
	光学部品	アジレント・テクノロジー社、ユーティナデバイス(株)
	個別素子	オン・セミコンダクタ社
ボード製品		インテル社/ダイアロジック製品、モトローラ社
ソフトウェア		マイクロソフト社
一般電子部品		コーセル(株)、コービン社

用語説明(1)

半導体製品	主な取扱商品	機能
カスタムIC	ASIC(富士通株) PLD(サイリックス社)	お客様の仕様に応じて作られる固有IC
専用IC	画像処理用IC 通信用・ネットワーク用IC	特定用途用に作られた専用IC
汎用IC	汎用リニアIC(アナログIC) 汎用ロジックIC	色々な用途に共通に使用されるIC
メモリIC	DRAM、SRAM フラッシュメモリ	記憶用IC、書込み、読出しが可能なものや 読出しのみのものがある
CPU	マイクロプロセッサ、DSP	演算機能、電子機器の頭脳
光学部品	発光ダイオード、フォトグラ	電気を光に変換して使用するIC
個別素子	整流素子、トランジスタ	増幅、整流などの機能を持つ部品

用語説明(2)

ボード製品		プリント配線基板の上にIC、電源、コネクタなどの部品を実装した製品
ソフトウェア		マイクロソフト社の産業機器に組み込まれるOSを中心に販売(PC用以外)
一般電子部品		機器間を接続するコネクタやケーブル、液晶表示部品、電源など、電子機器には不可欠な周辺部品